



SÜSS MicroTec AG

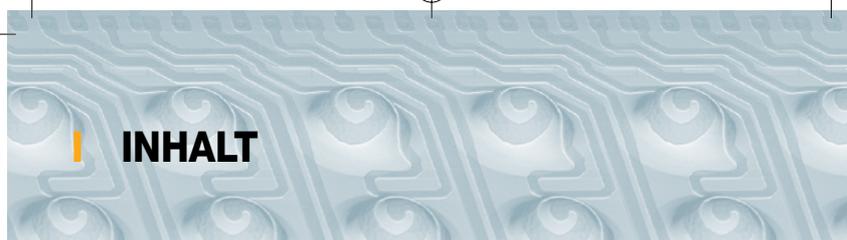
HALBJAHRESBERICHT

01. Januar – 30. Juni 2004



KENNZAHLEN Q2/2004

Millionen Euro	Q1/04	Q2/04	1.HJ/03	1.HJ/04
Auftragseingang netto	24,4	36,1	50,3	60,5
Auftragsbestand netto	38,8	--	40,7	48,7
Nettoumsatz	19,2	26,6	39,2	45,8
Eigenkapital	100,0	--	108,2	97,4
Eigenkapitalquote	64,6%	--	69,5%	63,0%
Liquide Mittel (netto)	22,5	--	18,5	20,9
Free Cash Flow	0,1	-1,0	7,1	-1,0
Rohertrag	6,2	9,9	14,2	16,1
Rohertragsmarge	32,3%	37,4%	36,3%	35,3%
EBITDA	-4,3	-1,1	-10,2	-5,4
EBIT	-5,6	-2,5	-13,5	-8,1
EAT (Ergebnis nach Steuern)	-5,0	-2,7	-8,8	-7,6
EPS (Ergebnis pro Aktie in Euro)	-0,33	-0,18	-0,59	-0,50
Anzahl der Mitarbeiter	720	--	727	734



Editorial	4
Hauptversammlung 2004	8
Positives Votum für SÜSS MicroTec	8
Neue Aufträge	10
Starke Position im Advanced Packaging-Markt	10
Neue Produkte	12
Beste Zuverlässigkeitstests in kürzester Zeit	12
Extremste Tests für 200mm- und 300mm-Bereich	14
Umsatz und Auftragslage	16
Umsatzentwicklung nach Produktlinien und Regionen	16
Auftragseingang nach Produktlinien und Regionen	17
Finanzbericht	18
Konzerngewinn- und Verlustrechnung	18
Konzernbilanz	20
Konzernkapitalflussrechnung	22
Konzerneigenkapitalentwicklung	24
Rechnungslegungsgrundsätze / Segmentberichterstattung	24
Aktien und Bezugsrechte der Organe	26
Unternehmenskalender 2004	26

EDITORIAL

Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG,

die positiven Aussichten der Halbleiterzulieferer für 2004 haben sich mittlerweile verfestigt. Auch bei uns stellte sich im zweiten Quartal die erwartete Belebung im Auftragseingang ein. Mit 36,1 Millionen Euro lag der Auftragseingang um 48 Prozent über dem ersten Quartal 2004 und um 44 Prozent über dem Vorjahreswert. Diese positive Entwicklung bestätigt uns auch in unserer Umsatzprognose von 115 bis 120 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2004, was einem Wachstum von 25 bis 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Zudem verbesserten wir im zweiten Quartal unseren Umsatz: Er stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 23 Prozent auf 26,6 Millionen Euro. Damit liegt der Umsatz allerdings noch unter der Break-Even-Schwelle. Die Rohertragsmarge im zweiten Quartal betrug 37,4 Prozent und lag damit unter dem Wert des Vorjahres (43,8 Prozent), bedingt unter anderem durch einen deutlichen Anstieg der ausstehenden Kundenabnahmen infolge erhöhter Lieferungen zum Quartalsende.

Beim EBITDA gab es, wie schon im ersten Quartal 2004, eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. SÜSS MicroTec reduzierte das EBITDA von -2,7 auf -1,1 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich, bedingt durch die geringe Steuerquote in 2004, im Jahresvergleich der Quartale nur geringfügig von -3,0 auf -2,7 Millionen Euro.



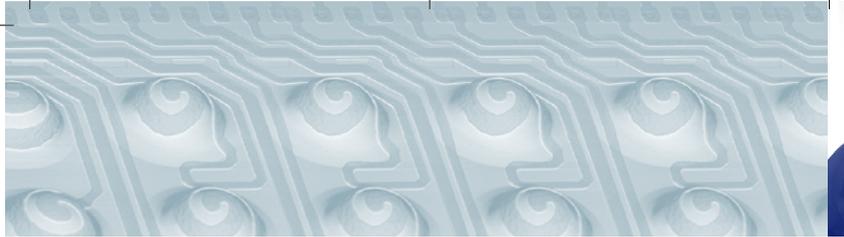
Wie bereits berichtet werden bei wesentlichen Tochtergesellschaften auf in 2004 entstehende Verluste derzeit keine latenten Steuern aktiviert.

Der Free Cash Flow lag im Berichtszeitraum bei -1,0 Millionen Euro – eine Entwicklung, die wir grundsätzlich so erwartet hatten. Jedoch entwickelte sich der Lagerbestand entgegen der geplanten Richtung. Er stieg im Vergleich zum ersten Quartal nochmals um 1,6 Millionen Euro an. Hierfür waren vor allem zwei Effekte verantwortlich:

- Weitere auftragsbedingte Bestandserhöhung bei den neuen Bond Clustern,
- Anstieg bei den Demogeräten, da mehrere strategisch wichtige Kunden kurzfristig Produktionsequipment zu Evaluierungszwecken erhielten.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Betrachtung des Lagerbestandes im Verhältnis zum Auftragsbuch: Unter Berücksichtigung des Auftragsbestandes zum 30. Juni 2004 in Höhe von 48,7 Millionen Euro ergibt sich hier eine deutlich verbesserte Relation. Für das zweite Halbjahr planen wir, mit Bezug auf unsere Prognose, Umsätze zwischen 69 und 74 Millionen Euro; dieser Zeitraum birgt das hauptsächliche Potenzial zum Abbau der Lagerbestände in 2004.

Für den weiteren Geschäftsverlauf 2004 ist nun entscheidend, dass sich die positive Entwicklung des Auftragseingangs im



Berichtszeitraum in den kommenden Quartalen verfestigt. Beim Blick auf den Auftragseingang nach Regionen zeigt sich, neben den guten Auftragseingängen aus Asien und den USA, in Europa dagegen noch eine große Zurückhaltung und große Unsicherheit bei den Investitionsentscheidungen – sicherlich auch unter dem Eindruck der unterschiedlichen Signale bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in Europa.

Die größte Nachfrage kommt aktuell aus den USA für den Bereich der Mikrosystemtechnik und aus Asien für das Advanced Packaging (siehe hierzu auch S. 10). Diese Entwicklung wurde auch durch das Kundeninteresse auf der weltweit bedeutendsten Messe für Halbleiterausrüster, SEMICON West bestätigt, die Mitte Juli in Kalifornien stattfand. Der Messerverlauf war für uns äußerst positiv – besonders unser Equipment für die Mikrosystemtechnik und die Optoelektronik stieß auf reges Interesse.

Auf der SEMICON West gab der SEMI-Verband zudem seine aktuellen Schätzungen bekannt: Für das laufende Jahr 2004 wird für die Industrie der Halbleiterausrüster ein Wachstum von über 60 Prozent erwartet; 2005 geht der SEMI-Verband von einem weiteren Wachstum von über 20 Prozent aus. Dieser Wachstumswert für 2005 mag zunächst gering klingen, stellt aber auf Basis des Wertes von 2004 eine beachtliche Größe dar.

Für SÜSS MicroTec ist besonders die Entwicklung im kommenden Jahr von großer Bedeutung, weil wir spätestens 2005



wieder deutliche Gewinne erreichen wollen. Der neue SEMI-Ausblick zeigt eindrucksvoll die Nachhaltigkeit der Erholung der Halbleiterindustrie. Unsere Aufgabe ist es, diese Chancen für unser Unternehmen weiterhin zu nutzen und in eine entsprechende Performance umzusetzen – im Hinblick auf unsere Geschäftsentwicklung als auch auf die Entwicklung unseres Aktienkurses.

Garching, im August 2004

F. Richter

Dr. Franz Richter
Vorstandsvorsitzender

Stephan Schulak

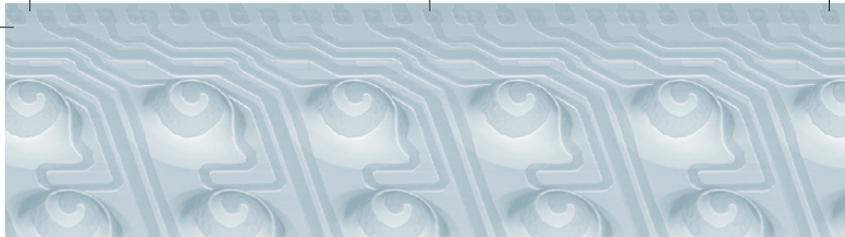
Stephan Schulak
Vorstand Finanzen

HAUPTVERSAMMLUNG 2004

Positives Votum für SÜSS MicroTec

Auf der diesjährigen Hauptversammlung am 16. Juni im Haus der Bayerischen Wirtschaft, München, vertraten die anwesenden Aktionäre 5.347.829 Stückaktien – und damit 35,28 Prozent des Grundkapitals. Neben der Vorlage und ausführlichen Erläuterung des Jahres- und Konzernabschlusses zum Stichtag 31. Dezember 2003 durch den Vorstand, gab es Abstimmungen zu den folgenden sechs Tagesordnungspunkten:

- Entlastung der Mitglieder des Vorstands:
Zustimmung: 99,97 Prozent
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats:
Zustimmung: 99,99 Prozent
- Bestellung der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG zum neuen Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer:
Zustimmung: 99,99 Prozent
- Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 06. Juni 2003, der dem Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages zustimmte:
Zustimmung: 99,99 Prozent
- Aufhebung des Genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von Euro 7.478.442,00 mit Ermächtigung zu teilweisem Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung:
Zustimmung: 94,20 Prozent



- Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-schuldverschreibungen, die Anpassung des Bedingten Kapitals 2002 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2004 und Satzungsänderung:

Zustimmung: 94,21 Prozent

Wie üblich stand der Vorstand den detaillierten Fragen des internationalen Publikums ausführlich Rede und Antwort. Tagesordnung, Rede des Vorstands, Präsentation sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung 2004 erhalten Sie unter:

www.suss.com/InvestorRelations/Hauptversammlung.

NEUE AUFTRÄGE

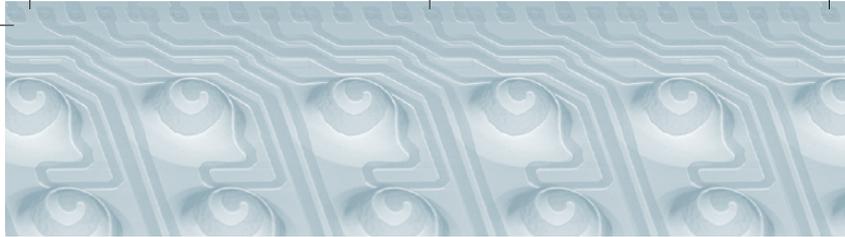
Starke Position im Advanced Packaging-Markt

Im 2. Quartal bestellten gleich mehrere bedeutende Unternehmen SÜSS MicroTec-Equipment für Advanced Packaging – der fortschrittlichen Verbindungstechnik für Halbleiterbausteine.

ASE, der weltweit größte Dienstleister (Foundry) für das Wafer-Packaging mit Sitz in Taiwan, orderte mehrere vollautomatische Mask Aligner mit der neuen „SupraYield“-Technologie sowie Coater/Developer-Systeme. Mit diesen Aufträgen, die sowohl für 200mm- als auch für 300mm-Waferformate eingesetzt werden, baut ASE seine führende Stellung im Foundry-Bereich hinsichtlich der installierten Bumping-Kapazität weiter aus. ASE wird das Wafer-Bumping – einer der wesentlichen Fertigungsschritte im Rahmen des Advanced Packaging-Verfahren – fast ausschließlich mit SÜSS MicroTec-Maschinen durchführen.

Zusätzlich entschied sich SPIL, weltweit die Nummer 3 unter den Packaging-Foundries und ebenfalls aus Taiwan, für 300mm-Systeme von SÜSS MicroTec (Mask Aligner mit „SupraYield“-Technologie und Coater/Developer-System). Ein strategischer Erfolg, denn SPIL setzte für das Wafer-Bumping zuletzt auch Wettbewerbs-Equipment ein.

Neuer Kunde von SÜSS MicroTec für 300mm-Equipment wurde im 2. Quartal ein großer Chiphersteller aus Japan. Die drei bestellten vollautomatischen Systeme – darunter erneut der Mask Aligner mit „SupraYield“ – werden vom Kunden zur Prozessierung von 200mm- und 300mm-Wafern eingesetzt. Neben Taiwan als wich-



tigsten asiatischen Markt für Advanced Packaging erschließt sich SÜSS MicroTec mit diesem Auftrag auch den japanischen 300mm-Markt.

Neben den oben erwähnten Aufträgen konnte ein weiterer strategisch wichtiger 200mm-Auftrag (Mask Aligner und Coater/ Developer) aus Taiwan verbucht werden: Erstmals erhielt SÜSS MicroTec eine Order von der Firma XinTec, einem wachstumsstarken Packaging-Dienstleister, der sich auf das so genannte Chip Scale Packaging (CSP) spezialisiert hat.

Beim CSP erfolgt der komplette Packaging-Prozess direkt auf dem Wafer – zusätzliche Prozessschritte wie etwa das Umverdrahten beim Wafer Level Packaging sind nicht notwendig. XinTec stellt mit der extrem effizienten und kostengünstigen CSP-Technologie in erster Linie optische Sensoren her, die etwa in Digitalkameras oder Handys eingesetzt werden.

Für alle Unternehmen waren bei Ihrer Equipment-Wahl folgende Kriterien ganz wesentlich mitentscheidend: Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit sowie niedrige Anschaffungskosten und hohe Produktivität. Mit anderen Worten: Die Cost of Ownership, die SÜSS MicroTec-Produkte gegenüber den Wettbewerbsgeräten auszeichnet. Hinzu kommt der Service vor Ort: Die SÜSS MicroTec-Niederlassungen in Hsin Chu, Taiwan, und Yokohama, Japan, garantieren eine rasche und umfassende Kundenbetreuung in der Region Asien; und mit der Sales- und Service-niederlassung in Shanghai, China, ist SÜSS MicroTec schon heute im Markt von morgen vertreten.

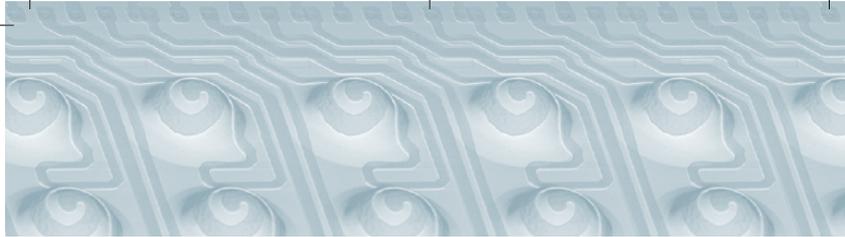
NEUE PRODUKTE

Beste Zuverlässigkeitstests in kürzester Zeit

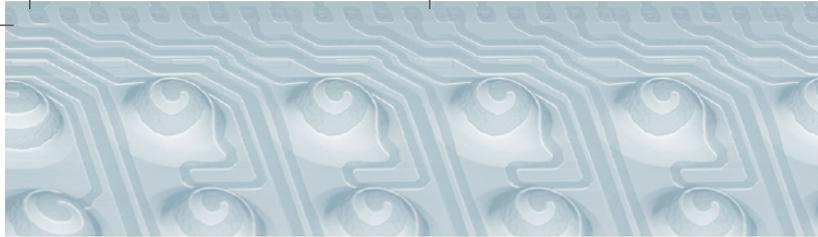
Mit dem neuen manuellen SÜSS MicroTec-Prober „PM8WLR“* kommt die Zuverlässigkeit von Chips jetzt so schnell, kostensparend und gleichzeitig präzise wie nie zuvor auf den Prüfstand.

Derartiges Testen von Chips gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das zeigt sich besonders beim Blick in den PC: In den Computer-Prozessoren „arbeiten“ heute etwa 50 Millionen Transistoren und sorgen rund um die Uhr für die enorme Leistungsfähigkeit unserer aktuellen PC-Generation – Anfang der 90er Jahre waren es noch unter vier Millionen Transistoren. Künftige Prozessoren werden laut Prognosen führender Chip-Hersteller aus 400 Millionen Transistoren und mehr bestehen, die noch schneller, kleiner und leistungsfähiger sind. Aber auch bei neuer Komplexität bleibt der „alte“ Anspruch: Die einwandfreie PC-Funktionalität muss für den Anwender jederzeit gewährleistet sein. Intensive Zuverlässigkeitstests sind deshalb unerlässlich.

Bisher waren diese sehr zeitaufwendig und damit kostenintensiv. Denn die Tests mußten entweder nacheinander an den vielen, einzelnen Teststrukturen (es befinden sich mehrere Hundert davon in den Ritzgräben**) durchgeführt werden, oder waren erst nach dem Vereinzeln und Verkapseln der Bauelemente möglich. Die Testdauer lag folglich bei einer oder mehreren Wochen pro Wafer. Je nach Testverlauf konnten die Hersteller bei diesen Vorgehensweisen deshalb neue Chips teilweise erst verspätet in den Markt einführen und hatten ein erhöhtes finanzielles Risiko während der Produktion, weil Abweichungen von den Zielparametern erst mit großer zeitlicher Verzögerung erkannt werden konnten.



Der „PM8WLR“ hingegen analysiert auf Wafer-Ebene jede einzelne der 200 bis 300 Teststrukturen gleichzeitig. In der Praxis sieht das etwa folgendermaßen aus: Jede winzige Teststruktur in den Ritzgräben des Wafers wird über einen bestimmten Zeitraum bei den für Zuverlässigkeitstests notwendigen Temperaturen (-65 Grad Celsius bis 300 Grad Celsius) ohne Unterbrechung kontaktiert. Die gewonnenen elektrischen Daten der Langzeitmessung (dauert mehrere Minuten) werden einem mathematischen Modell zugeführt, das aus der Vielzahl der Daten die Zuverlässigkeit und voraussichtliche Lebensdauer der Schaltkreise berechnet. Durch den Einsatz einer so genannten Prüfkarte kann der Prober „PM8WLR“ alle Transistoren parallel „bearbeiten“. Die Testzeit pro Wafer reduziert sich von Wochen auf Stunden. Für unsere Kunden bedeutet das: Erheblich schnellere Testdurchläufe bei deutlich geringeren Produktionskosten.



Extremste Tests für 200mm- und 300mm-Bereich

SÜSS MicroTec überzeugte als ersten Kunden für seine Technologie neuheit „Cyrogenic Prober PAC 200/300“ einen der größten Halbleiterhersteller der Welt mit Sitz in den USA. Der strategisch wichtige Kunde setzt das hochspezielle Analysegerät im 300mm-Forschungs- und Entwicklungsbereich ein. Konkret geht es um Tests neuer Materialien, die zur Herstellung der kommenden „intelligenten“ Computer genutzt werden (so genannte Super-Computer). Zur Zeit erfolgt die aufwendige Forschungsarbeit mit den entsprechenden Tests hier noch überwiegend im 200mm-Bereich. Zunehmend wollen Hersteller aber die Option, dass sie die individuellen Tests auch im 300mm-Bereich durchführen können.

Der halbautomatische Cyrogenic Prober aus der Produktlinie Vakuumprober ist darüber hinaus für eine Vielzahl weiterer Analysen nutzbar – etwa für Tests äußerst sensibler „Teilchen“ in der Mikrosystemtechnik, wie beispielsweise Infrarotsensoren. Bei SÜSS MicroTec steht der Cyrogenic Prober dabei nicht nur wie der Name sagt für Tests bei tiefen Temperaturen – sondern für Tests nahe der absoluten Temperaturgrenze von -273 Grad Celsius: Mit -269 Grad Celsius stellt der PAC 200/300 die extremsten Testbedingungen in seinem Gebiet her. Für den 300mm-Bereich ist das ein absolutes Novum.

| SÜSS MicroTec AG

ANHANG

Umsatz	16
Auftragseingang	17
Konzerngewinn- und Verlustrechnung	18
Konzernbilanz	20
Konzernkapitalflussrechnung	22
Konzerneigenkapitalentwicklung	24
Rechnungslegungsgrundsätze	24
Segmentberichterstattung	24
Aktien- und Bezugsrechte der Organe	26
Unternehmenskalender	26

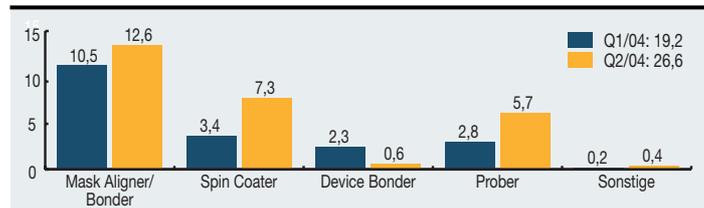
SÜSS MicroTec AG

UMSATZ

Der Gesamtumsatz von 26,6 Mio. Euro in Q2/2004 bzw. von 36,1 Mio. Euro im 1. HJ/2004 teilt sich nach Produktlinien und Regionen wie folgt auf:

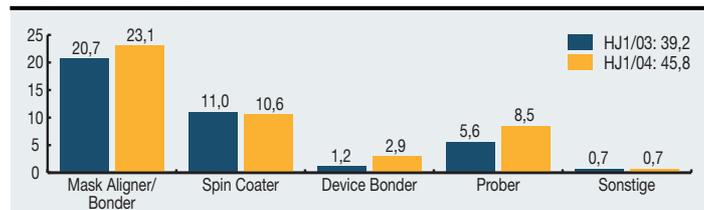
Umsatzentwicklung nach Produktlinien (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



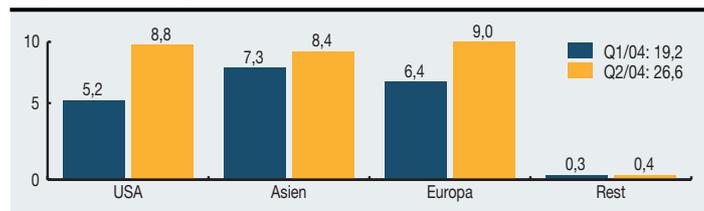
Umsatzentwicklung nach Produktlinien (Halbjahre)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



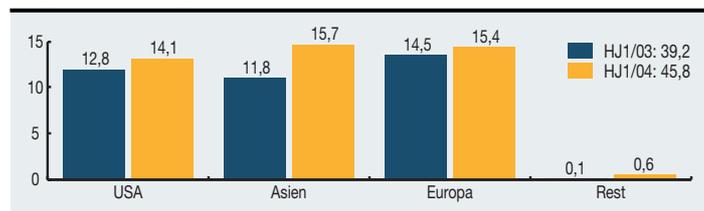
Umsatzentwicklung nach Regionen (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



Umsatzentwicklung nach Regionen (Halbjahre)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



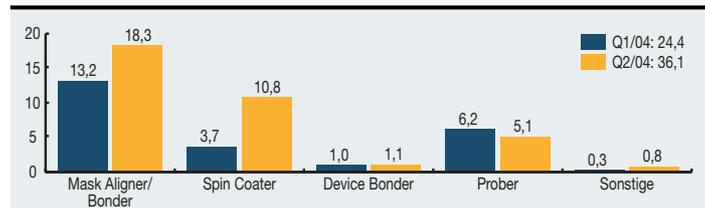
SÜSS MicroTec AG

AUFTRAGSEINGANG

Der Auftragseingang von 36,1 Mio. Euro in Q2/2004 bzw. von 60,5 Mio. Euro im 1. HJ/2004 teilt sich nach Produktlinien und Regionen wie folgt auf:

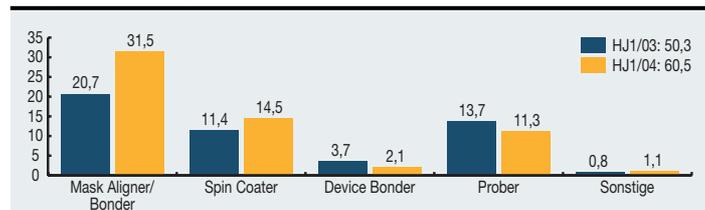
Auftragseingang nach Produktlinien (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



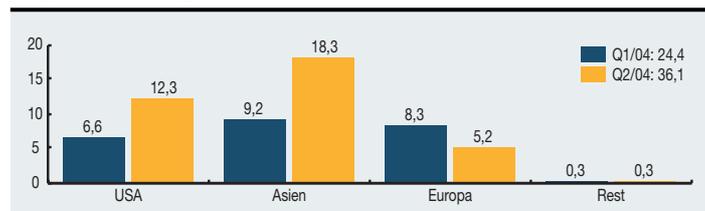
Auftragseingang nach Produktlinien (Halbjahre)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



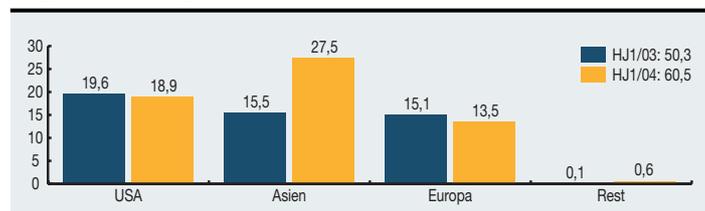
Auftragseingang nach Regionen (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



Auftragseingang nach Regionen (Halbjahre)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro





TEUR

Umsatzerlöse

Frachtkosten und Provisionen

Umsatzerlöse netto

Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen

Bruttoergebnis vom Umsatz

Allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten

Forschungs- und Entwicklungskosten

Abschreibung des Firmenwerts

Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Erträge / Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung

Operatives Ergebnis

Zinsaufwendungen

Zinserträge

Anteil der Minderheitsaktionäre am Ergebnis

Ergebnis vor Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

Earnings before Interest and Taxes (EBIT)*

Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and

Amortization (EBITDA)*

Pro Aktie:

Unverwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR

Verwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR

Überleitung zum Comprehensive Income

Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

Sonstiges Comprehensive Income nach Steuern

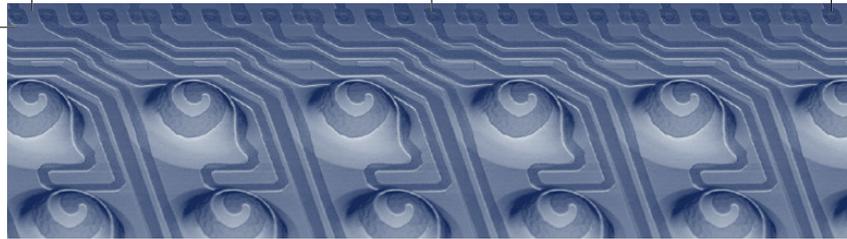
Fremdwährungsdifferenzen

Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellungen

Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren

Comprehensive Income

* ungeprüft



01.04.2003- 30.06.2003*	01.01.2003- 30.06.2003*	01.01.2003- 31.12.2003	01.04.2004- 30.06.2004*	01.01.2004- 30.06.2004*
22.184	40.465	95.500	27.179	47.195
-589	-1.291	-2.885	-614	-1.390
21.595	39.174	92.615	26.565	45.805
-12.137	-24.969	-56.168	-16.635	-29.658
9.458	14.205	36.447	9.930	16.147
-10.808	-21.322	-40.985	-10.668	-20.117
-2.482	-4.918	-10.496	-2.272	-5.118
0	0	0	0	0
650	624	859	418	570
-1.053	-2.029	-2.916	118	387
-4.235	-13.440	-17.091	-2.474	-8.131
-412	-625	-1.245	-386	-769
118	179	358	90	187
-30	-22	24	-2	12
-4.559	-13.908	-17.954	-2.772	-8.701
1.563	5.103	3.401	101	1.076
-2.996	-8.805	-14.553	-2.671	-7.625
-4.265	-13.462	-17.067	-2.476	-8.119
-2.655	-10.170	-10.996	-1.105	-5.407
-0,20	-0,59	-0,97	-0,18	-0,50
-0,20	-0,59	-0,97	-0,18	-0,50
-2.996	-8.805	-14.553	-2.671	-7.625
-728	-1.840	-2.255	-15	432
0	0	-14	0	0
0	0	47	0	0
-3.724	-10.645	-16.775	-2.686	-7.193

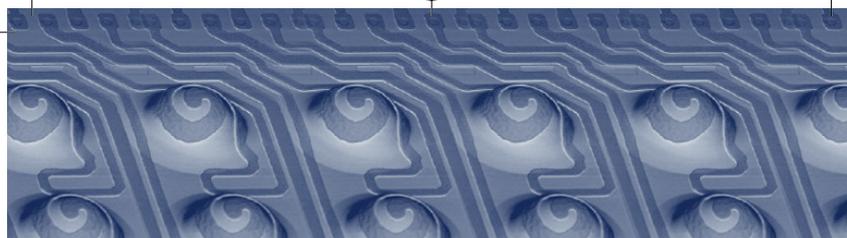


SÜSS MicroTec AG

KONZERNBILANZ

TEUR	30.06.2003*	31.12.2003	30.06.2004*
AKTIVA			
Flüssige Mittel	21.548	26.785	24.095
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	17.433	23.606	17.788
Sonstige kurzfristige Forderungen	6.114	6.603	6.260
Vorräte, netto	46.433	41.900	47.585
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	674	1.094	1.045
Kurzfristige aktive latente Steuern	3.827	2.091	3.315
Summe Umlaufvermögen	96.029	102.079	100.088
Sachanlagen	14.323	11.935	10.542
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.423	7.305	6.427
Goodwill	28.009	28.009	28.009
Finanzanlagen	148	144	144
Langfristige aktive latente Steuern	6.809	7.480	7.521
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	2.021	1.901	1.923
Summe Anlagevermögen	59.733	56.774	54.566
Summe Aktiva	155.762	158.853	154.654

* ungeprüft



TEUR	30.06.2003*	31.12.2003	30.06.2004*
PASSIVA			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	3.098	3.154	3.152
Kurzfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten	150	158	139
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.979	5.972	8.413
Kurzfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	223	214	212
Kurzfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	3.440	2.991	2.476
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	19.034	16.929	19.240
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	29.924	29.418	33.632
Langfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	12.801	22.423	19.165
Langfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten	549	473	423
Langfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	3.622	3.581	3.558
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	615	517	487
Minderheitenanteil an Konzerngesellschaften	52	32	19
Summe langfristige Verbindlichkeiten	17.639	27.026	23.652
Gezeichnetes Kapital, genehmigte Anzahl von Aktien zu EUR 1,00 (in tsd.) 22.635 (30.06.2004) und genehmigte Anzahl von Aktien zu EUR 1,00 (in tsd.) 22.423 (31.12.2003); davon ausgegeben (in tsd.) 15.157 (30.06.2004) bzw. 14.957 (31.12.2003)	14.957	14.957	15.157
Kapitalrücklage	81.221	81.561	83.515
Gewinnrücklagen	433	433	433
Gewinnvortrag	16.832	11.084	3.459
Kumuliertes Other Comprehensive Income	-5.244	-5.626	-5.194
Summe Eigenkapital	108.199	102.409	97.370
Summe Passiva	155.762	158.853	154.654

* ungeprüft

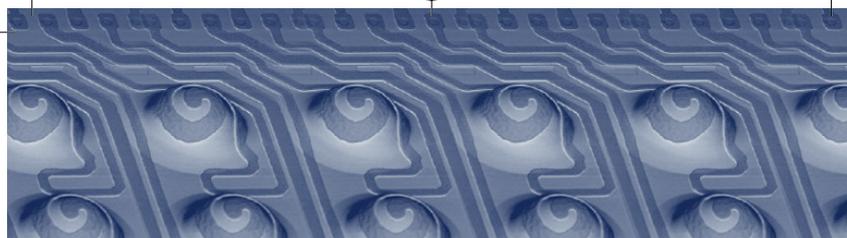


SÜSS MicroTec AG

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01.2003- 30.06.2003*	01.01.2003- 31.12.2003	01.01.2004- 30.06.2004*
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit			
Jahresfehlbetrag	-8.805	-14.553	-7.625
Wechselkursbedingte Veränderung des kurzfristigen Nettovermögens	-984	134	62
Anpassung zur Überleitung des Jahresfehlbetrages zum Mittelab-/zufluss aus der lfd. Geschäftstätigkeit			
Zuführung zur Kapitalrücklage für Bezugsrechte	310	650	194
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	956	1.965	919
Abschreibung auf den Goodwill	0	0	0
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	2.126	3.784	1.712
Abschreibungen auf Leasinggegenstände	210	322	81
Veränderung der aktiven latenten Steuern	-2.336	-1.271	-1.265
Verlust / Gewinn aus Abgang von Anlagegegenständen	32	551	0
Gewinn aus Beteiligungen	0	4	0
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	34	333	-393
Veränderung der Wertberichtigung auf Vorräte	1.266	337	176
Veränderungen von Aktiva und Passiva			
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.638	10.166	6.211
Veränderung der Vorräte	363	5.825	-5.861
Veränderung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	284	366	49
Veränderung der sonstigen Aktiva	3.054	2.685	321
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45	2.038	2.441
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungspostens	-5.398	-7.503	2.311
Veränderung der Pensionsverbindlichkeiten	42	-8	-25
Veränderung der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten	-120	-238	-43
Mittelab-/zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.717	5.587	-735

* ungeprüft



TEUR	01.01.2003- 30.06.2003*	01.01.2003- 31.12.2003	01.01.2004- 30.06.2004*
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-613	-1.010	-215
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-42	-10	-3
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und Finanzanlagen	0	3	0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-655	-1.017	-218
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus der Begebung einer Wandel- und Optionsanleihe	0	11.642	0
Kosten der Wandel- und Optionsanleihe	0	-502	0
Tilgung von Bankdarlehen	-1.806	-4.275	-1.813
Änderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-433	-377	-2
Tilgungen / Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing	-189	-257	-69
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.428	6.231	-1.884
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes			
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes	-659	-930	147
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang	17.573	16.914	26.785
Finanzmittelbestand zum Ende der Periode	21.548	26.785	24.095
Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung			
Zinszahlungen während der Periode	577	773	689
Einkommensteuererstattungen/-zahlungen während der Periode inkl. Vorauszahlungen	1.917	3.767	95
Zusätzliche Darstellung nicht zahlungswirksamer Investitions- und Finanzierungstätigkeiten			
Zugang zum Finanzierungsleasing	31	0	0

* ungeprüft



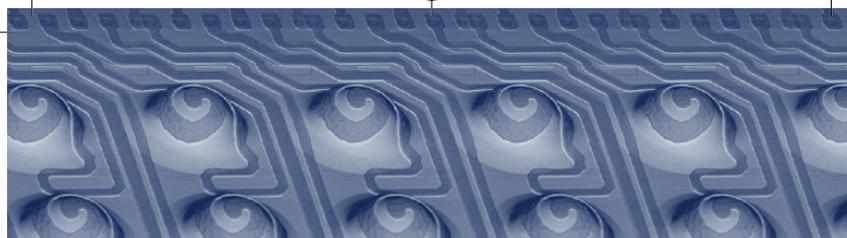
TEUR	Anzahl der Aktien in tausend Stück	Gezeichnetes Kapital
Stand 01.01.2003	14.957	14.957
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresfehlbetrag		
Fremdwährungsanpassung		
Stand 30.06.2003	14.957	14.957
Stand 01.01.2004	14.957	14.957
Wandlung von Wandelschuldverschreibungen in Gezeichnetes Kapital	200	200
Zuführung aus der Wandlung von Wandelschuldverschreibungen		
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresfehlbetrag		
Fremdwährungsanpassung		
Stand 30.06.2004	15.157	15.157

Rechnungslegungsgrundsätze

Die dargestellten Angaben zum Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG entsprechen den Vorschriften der US-amerikanischen Generally Accepted Accounting Principles („US-GAAP“). Der Zwischenabschluss zum 30. Juni 2004 wurde unter Beachtung derselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt, die auch dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2003 zugrunde lagen und im Anhang ausführlich erläutert wurden.

Segmentberichterstattung

Die SÜSS MicroTec AG und ihre Tochterunternehmen sind lediglich in einem Segment tätig. Eine Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Segmente entfällt aus diesem Grund.



Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Gewinnvortrag	Kumuliertes Other Compre- hensive Income	Gesamt
80.911	433	25.637	-3.404	118.534
310				310
		-8.805		-8.805
			-1.840	-1.840
81.221	433	16.832	-5.244	108.199
81.561	433	11.084	-5.626	102.409
				200
1.760				1.760
194				194
		-7.625		-7.625
			432	432
83.515	433	3.459	-5.194	97.370



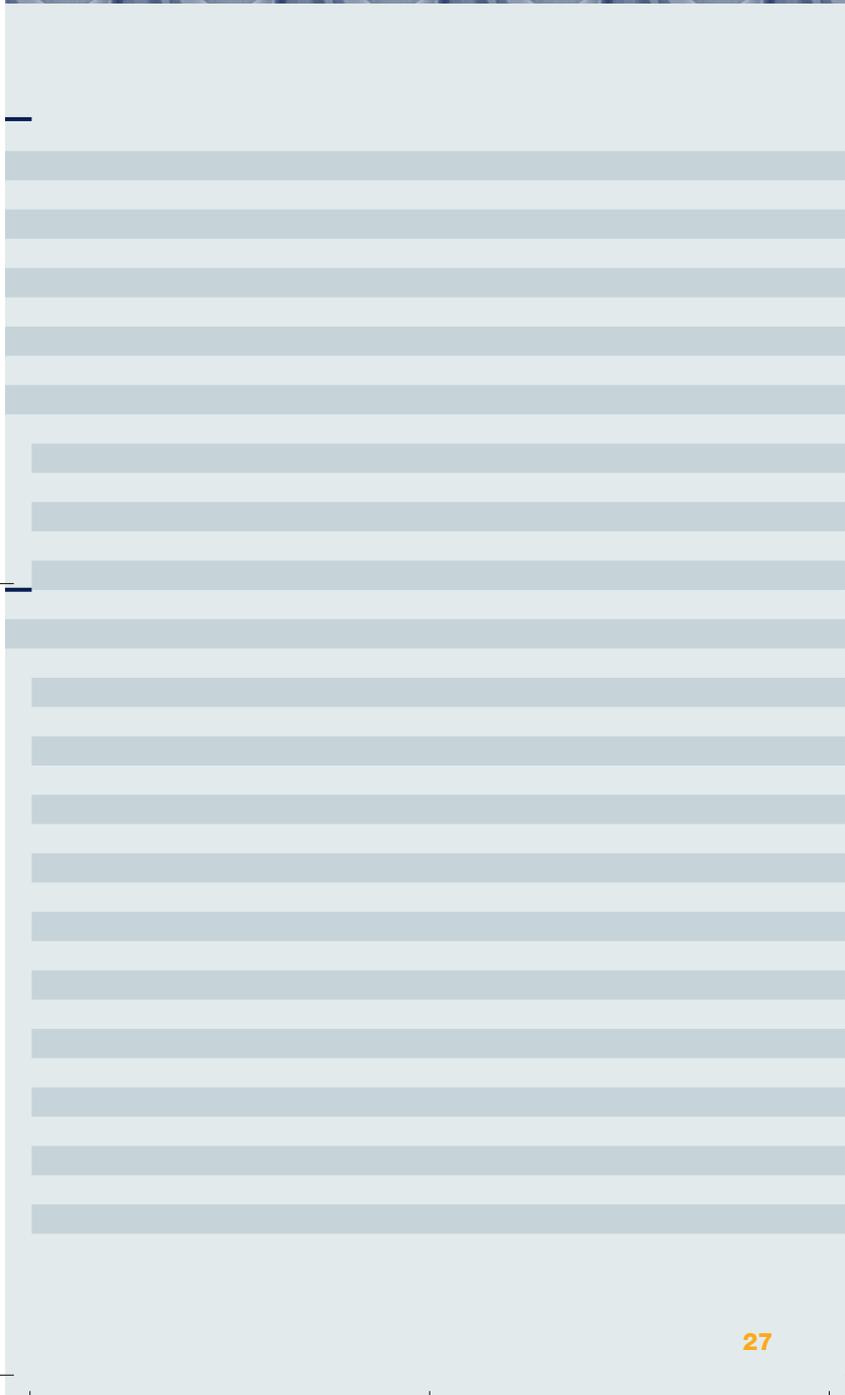
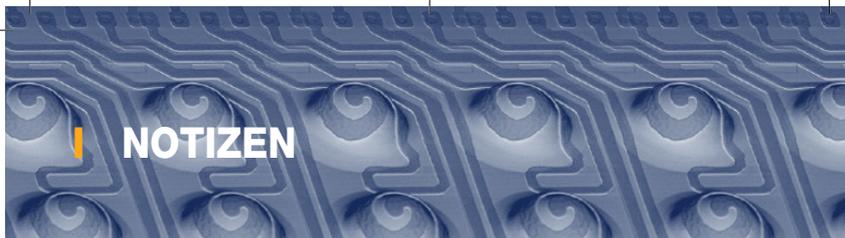
SÜSS MicroTec AG

AKTIEN UND BEZUGSRECHTE DER ORGANE

Aktien und Bezugsrechte der Organe	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
	31.12.2003	31.12.2003	30.06.2004	30.06.2004
Vorstand				
Dr. Richter	400.000	105.000	400.000	105.000
S. Schulak	0	40.286	0	40.286
Aufsichtsrat				
Dr. Süß (Vors.)	1.025.000	0	1.025.000	0
T. Schlytter-Henrichsen (stellv. Vors.)	6.909	0	6.909	0
Dr. h. c. Görtz	3.894	0	3.894	0
Prof. Dr. Heuberger	0	0	0	0
Dr. Schücking	500	0	500	0
Dr. Sesselmann	0	0	0	0

Unternehmenskalender 2004

09.11. Neunmonatsbericht



I **SÜSS MicroTec AG**

Schleissheimer Strasse 90
D-85748 Garching

Telefon: (+49)-(0) 89/3 20 07-314
Fax: (+49)-(0) 89/3 20 07-450

E-Mail: ir@suss.de

www.suss.com



Gestaltung
strittmatter&jacobs GmbH & Co. KG, Köln

Druck
Schotte GmbH & Co. KG, Ürdingen

SUSS MicroTec AG